

股票简称：利和兴

股票代码：301013

深圳市利和兴股份有限公司

Shenzhen Lihexing Co.,Ltd.

深圳市龙华区观湖街道松轩社区环观中路 308 号立伟工业园厂房四 102



2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告

二〇二五年八月

一、本次募集资金的使用计划

本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 16,750.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下投资项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
1	半导体设备精密零部件研发及产业化项目	13,250.60	11,750.00
2	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		18,250.60	16,750.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目情况

（一）半导体设备精密零部件研发及产业化项目

1、项目基本情况

本项目计划投资 13,250.60 万元，拟使用募集资金金额 11,750 万元。项目建成后，将有效提升公司半导体设备精密零部件的生产制造能力，满足公司经营需求，为公司未来业务发展奠定坚实基础。

2、项目实施主体、选址和用地

本项目的实施主体为利和兴江门，建设地点位于广东省江门市。项目实施主体利和兴江门已取得该项目的土地使用权，不动产权证号为“粤（2021）江门市不动产权第 1019624 号”。

3、项目投资概算

本项目总投资额不超过 13,250.60 万元，拟使用募集资金 11,750 万元，项目

建设期为 24 个月。

4、项目实施的必要性

(1) 紧跟产业链自主可控发展战略，把握半导体国产替代市场发展机遇

集成电路半导体产业是我国扎实推进科技强国建设的重要一环，属于战略科技力量自立自强的核心支撑产业。伴随着人工智能、先进消费电子和汽车电子等产业的快速发展，半导体产品的需求呈现不断增长的趋势。根据 WSTS 统计，2025 年全球半导体市场规模将达到 7,009 亿美元，同比增长 11.2%。

终端需求的持续增长带动了半导体设备行业的发展，根据 SEMI 的统计，2024 年全球半导体制造设备出货金额达到了 1,171 亿美元，中国大陆半导体设备支出规模全球居首，同比增长 35%，达到 496 亿美元。2025 年全球半导体制造设备总销售额预计将创下 1,255 亿美元的新纪录，同比增长超过 7%。作为半导体设备的核心单元，半导体设备零部件系半导体产业发展之本，对于推动我国半导体产业的长远发展起到了关键作用。

尽管当前我国半导体产业处于加速发展阶段，但由于我国半导体产业起步较晚，原始创新能力还相对薄弱，一些关键核心技术仍受制于人，因此打造自主可控、安全可靠的半导体产业体系，实现半导体设备及零部件国产替代，可以有效保障高质量科技供给，推动产业高质量发展。

根据 SEMI 的预测，至 2026 年，中国大陆、中国台湾和韩国将继续保持设备支出前三甲地位，而中国大陆在预测期内将继续领跑所有地区。伴随设备国产化进程加速，半导体设备精密零部件的国产化率也正在不断提升，为本土零部件供应商带来了重大机遇。叠加国内广阔的市场需求、强有力的国家政策与资金支持，以及国产替代进程的持续深入，多方有利因素共同为国内半导体设备零部件行业的发展注入了强劲动力并奠定了乐观前景。

(2) 推动业务延伸，完善产品矩阵，增强公司核心竞争力

公司始终专注于智能装备及专用配件制造，产品融合了自动控制、机器视觉、

人工智能、信息通信、精密机械等技术，实现智能装配、检测、仓储、物流等功能。一直以来，公司以信息和通信技术领域为基础，积累了丰富的精密加工和装备集成经验，但受下游终端产品需求波动和大客户被美国政府采取管制措施等因素影响，依靠单一产品应用领域难以推动公司业务长远发展。公司通过不断的研发创新，围绕不同应用领域的客户需求定制开发，拓展公司产品品类，逐步将产品应用领域拓展至新能源汽车、数字能源、半导体等。随着下游客户的业务发展及需求变化，公司结合自身战略规划，在本项目中将产品在半导体应用领域中进一步拓展，完善产品矩阵的同时，继续增强公司的核心竞争力。

目前，半导体设备零部件国产替代已经成为未来发展趋势，市场需求强劲，此时积极推动业务延伸将有助于未来带动公司业务的加速增长，推动公司在智能制造领域的业务拓展，改善整体经营质量。

5、项目实施的可行性

（1）符合国家产业政策导向，具有广阔的市场空间

当前，我国是全球最大的半导体设备消费市场，对半导体设备零部件也有巨大的需求。由于半导体设备的可靠性及精密度相较于其他应用领域的自动化设备要求更为苛刻，因此相关零部件往往需要兼顾精度、强度、洁净度、抗腐蚀、电子特性、电磁特性、材料纯度等复合功能要求，技术实现难度相对较大。

目前，半导体设备零部件行业整体集中度较为分散，总体来看海外厂商持续领先，而国内厂商尚处发展期，部分零部件仍在国产替代初期。在海外技术封锁和贸易摩擦等不确定性因素增加的背景下，半导体产业加速国产替代进程，实现半导体产业自主可控已上升到国家战略高度。2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出，培育先进制造业集群，推动集成电路等产业创新发展，加强集成电路重点装备研发，瞄准集成电路等前沿领域，打好关键核心技术攻坚战。

在国家强有力的政策支持下，半导体行业持续发力，多年保持相关设备支出的领先地位，叠加西方国家对我国相关设备、产品和技术的限制因素，国产半导

体设备零部件需求将大幅增加，市场前景广阔。

（2）优质的客户资源为项目实施提供有利条件

公司服务的客户包括华为、新凯来、荣耀、中兴通讯、比亚迪、深科技等知名企业，公司分别在移动智能终端、新能源汽车、半导体等多个应用领域为其提供智能制造设备类产品、专用配件和技术服务。凭借出色的研发技术、稳定的产品质量、优良的产品服务和合理的销售价格，公司得到了客户的广泛认可，并建立了长期稳定的合作关系，品牌知名度不断提升，为公司进一步开拓相关领域市场夯实了品牌优势。

智能装备及其精密部件是客户生产制造过程中的关键制约要素，公司产品凭借长期持续稳定运行的优异性能极大地增加了客户满意度，进一步提升了客户的黏性。此外，公司凭借快速及时的响应能力和以客户为中心的服务意识建立了良好的品牌形象和广泛的市场影响力，在行业内形成了具有竞争力的综合服务优势。因此，持续和稳定的优质客户资源为公司与客户进一步开拓、加深半导体零部件业务提供了有利条件。

（3）丰富的技术积累为项目实施提供保障

智能制造装备行业属于科技创新型产业，是典型的技术密集型行业，掌握核心技术和具备持续创新能力是企业的核心竞争力所在。公司深耕智能制造行业，相关产品的设计、制造和装配涉及机械学、电子学、光学、软件等多项领域，对涉及的诸如产品设计及定制开发、精密加工、焊接、自动控制等各项技术有较丰富的技术积累。

智能制造相关生产技术应用领域广，具备实现功能多样化的能力，能够结合不同行业的客户需求进行较高程度的定制化，但同时也对生产制造企业的产品开发能力和精密加工技术提出了更高的要求。通过公司持续的研发投入和研发人员的不懈创新，截至 2025 年 6 月 30 日，公司取得了发明专利 44 项，实用新型专利 143 项，28 项外观专利，275 项软件著作权。凭借丰富的技术储备，公司的竞争优势得以巩固，为更好地服务半导体行业客户提供了技术保障。

此外，公司目前已形成一套完善的管理运作体系，并且高度重视激发员工创新创造能力、不断丰富技术储备、积累行业项目经验和培养复合型人才队伍。公司凭借优秀的技术研发和生产实力，先后被评定为国家知识产权优势企业和国家级专精特新“小巨人”企业等。

6、项目涉及的备案、环评等审批情况

本项目已于 2025 年 8 月 4 日取得江门市江海区发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》（项目代码：2508-440704-04-05-408698）。

项目相关环评批复手续正在办理中。

7、项目预期效益

根据项目有关的可行性研究报告，项目内部收益率为 15.08%（所得税后），预计投资回收期（所得税后，含建设期）为 7.85 年，项目经济效益前景较好。

（二）补充流动资金

1、项目基本情况

公司综合考虑了行业发展趋势、自身经营特点以及业务发展规划等情况，拟将本次募集资金中的 5,000.00 万元用于补充流动资金。

2、项目实施的必要性

随着公司业务的发展，公司产品结构不断丰富、业务规模稳步增长，对流动资金的需求将日益增加。本次募集资金部分用于补充流动资金有助于缓解公司日常经营的资金压力，优化公司的财务结构，提高抗风险能力，为未来公司业务规模扩张提供保障，为公司可持续发展打下良好的基础。

3、项目实施的可行性

公司已建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。结合监管要求，公司制定了《募集资金管理制度》，严格规范募集资金的存储及使用。本次发行募

集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金违规使用风险。

三、本次发行募集资金投资项目对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目结合了公司现状、市场需求及未来行业发展趋势，围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策和公司未来整体战略的发展方向。通过本次募投项目的实施，可以有效提升公司在半导体设备精密零部件领域的研发及生产能力，提升公司经营效率，巩固并扩大公司在核心领域的竞争优势，符合公司长期发展需求及股东利益。

（二）对公司财务状况的影响

在本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的总资产规模将相应的增加，资金使用的灵活性将得到提升，募集资金将为公司业务发展提供有利保障。

本次募集资金投资项目具有良好的经济效益，虽然在建设期内可能导致每股收益出现一定程度的下降，但随着募投项目建设完毕并逐步释放效益，公司的经营规模和盈利能力将得到提升，综合实力将有所增强，募投项目建设将促进公司持续健康发展，为公司股东贡献回报。

四、本次发行募集资金投资项目可行性分析结论

本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金投资项目围绕公司主营业务拓展开展，符合行业发展趋势、公司战略规划需求以及相关政策和法律法规，具有较好的市场前景。通过本次募投项目的实施，将进一步提升公司业务规模和资金实力，增强公司核心竞争力，有利于公司可持续发展，符合公司及全体股东的利益。因此，本次募集资金投资项目是必要的、可行的。

深圳市利和兴股份有限公司董事会

2025年8月7日